



## NXP, 지오 플랫폼과 협력해 인도의 5G 사용 사례 확대

- 지오 플랫폼, NXP 레이어스케이프 프로세서 활용해 새로운 5G NR O-RAN 소형 셀 구축
- 이번 협업은 3GPP 및 O-RAN을 준수하는 최첨단 무선 제품을 제공하는 것을 목표로 함
- 광대역 액세스, 4차 산업 및 기타 애플리케이션을 위한 성능을 제공하는 솔루션

**2021년 6월 30일** – NXP 반도체와 RIL의 자회사인 인도의 지오 플랫폼(Jio Platforms Ltd., JPL)은 NXP의 레이어스케이프(Layerscape)® 멀티코어 프로세서 제품군이 적용된 5G NR O-RAN 소형 셀 솔루션을 구현하기 위한 협업을 발표했다. 이 통합 솔루션은 고성능을 제공하는 새로운 RAN 네트워크를 지원해 광대역 액세스 뿐만 아니라 원격 의료, 원격 교육, 증강/가상 현실, 드론 기반 농업 모니터링을 포함한 4차 산업 및 IoT(사물인터넷) 애플리케이션을 위한 광범위한 5G 사용 사례를 가능하게 한다.

JPL은 혁신적인 4G 및 5G 솔루션을 제공하는 기술 선도 기업이며 인도 최대 이동통신 네트워크 사업자이자 세계에서 3번째로 큰 이동통신 네트워크 사업자인 지오(Jio)의 지주회사다. JPL은 혁신적인 기술 솔루션을 지속적으로 활용하여 방대한 고객층을 지원하고 있으며 인도의 5G 기회에 대응하기 위해 발빠르게 움직이고 있다.

JPL은 새로운 5G NR 솔루션에서 NXP의 레이어스케이프 프로세서의 뛰어난 성능과 유연성을 활용했다. 이 조합은 최대 데이터 전송률이 1Gbps 이상인 3.5GHz 대역에서 100MHz 채널 대역폭을 성공적으로 테스트한 강력한 오피어링을 가능하게 한다. 이는 광범위한 분야의 성능 확장으로 이어져 스마트 시티, 스마트 홈, 건강 및 교육 분야에서 혁신적인 애플리케이션을 가능하게 하며 모든 모바일 사용자의 데이터 다운로드 속도에 있어 사용자 경험을 크게 향상시킨다. 그 결과 JPL의 5G NR 무선 솔루션은 차세대 RAN 네트워크에 이상적이며 실내 및 실외에서 향상된 성능을 제공하고 광범위한 5G 사용 사례를 지원한다.

아유시 바트나거(Aayush Bhatnagar), 지오 플랫폼 수석 부사장은 "NXP 프로세서 플랫폼은 지오의 5G 여정에서 중요한 역할을 한다. 신규 5G 무선 솔루션은 플랫폼 기능, 효율성 및 풍부한 툴링 측면에서 유연성을 필요로 하는데 NXP가 이를 제공했다. 지오 플랫폼은 NXP와 함께 3GPP와 O-RAN 표준을 준수하는 최첨단 무선 제품을 개발했다. 우리는 NXP와 긴밀하게 협력해왔으며, 앞으로도 협업을 더욱 강화할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

NXP의 레이어스케이프® 멀티코어 프로세서 제품군은 고도로 통합된 시스템을 구현하기 위해 광범위한 고속 SerDes 인터페이스와 함께 Arm 64비트 코어, 네트워킹 및 보안 오프로드 엔진을 결합하여 높은 수준의 통합과 강력한 성능을 제공한다. 하드웨어 네트워킹 오프로드에는 스위칭, 타이밍, 구문 분석 및 QoS(Quality of Service)가 포함되며, 가상화 및 컨테이너형 L1/L2 애플리케이션을 비롯한 eCPRI



C/U 및 S-Plane 오프로드에 대한 오프로드를 제공한다. 전체 시스템은 소프트웨어 프로그래밍 가능한 구현을 통해 효율적이고 확장 가능한 성능을 제공한다.

타레크 부스타미(Tareq Bustami) NXP 반도체 네트워크 엣지 부문 수석 부사장 겸 총괄은 "지오와 협력해 5G 솔루션을 개발, 테스트 및 구축한 것은 레이어스케이프 제품의 저력과 새로운 5G 구축을 가속화할 수 있는 NXP의 안테나에서 프로세서까지 포괄하는 포트폴리오의 성장성을 강조한다. 지오와 NXP는 모두 기술 및 혁신 리더십에 중점을 두고 있으며, 이러한 통합 시스템은 인도 시장에 효율적인 5G NR 솔루션을 제공하고자 하는 우리의 공통된 비전을 보여준다"고 말했다.

### **NXP의 5G 액세스 엣지 포트폴리오**

안테나에서 프로세서에 이르기까지 NXP는 인프라, 산업 및 자동차 애플리케이션을 위한 동급 최고의 성능과 보안을 제공하는 5G 구축을 가속화하기 위한 강력한 기술 포트폴리오를 제공한다. 포트폴리오에는 에어패스트(Airfast) RF 전력 솔루션 제품군과 무선 데이터 링크, 고정 무선 액세스 및 소형 셀 장치용 다중 코어 프로세서인 레이어스케이프(Layerscape) 제품군이 포함된다.

### **NXP 반도체 소개**

NXP® 반도체(나스닥: NXPI)는 더욱 편리하고 안전하며 더 나은 삶을 위한 첨단 솔루션을 개발하여, 안전하게 연결되는 스마트 월드를 만들고 있다. NXP는 임베디드 애플리케이션용 보안 연결 솔루션의 선도 기업으로서, 자동차, 산업 및 IoT, 모바일, 통신 인프라 시장의 혁신을 주도하고 있다. NXP는 60년 이상의 전문성과 경험을 바탕으로, 전 세계 30개 이상의 국가에서 29,000명의 직원을 고용하고 있다. 2020년 매출은 미화 86억 1천만 불이다. NXP 관련 뉴스는 [www.nxp.com](http://www.nxp.com)에서 찾아볼 수 있으며, NXP 반도체 블로그 (<http://blog.naver.com/nxpkor>) 에서도 NXP 관련 정보를 확인할 수 있다.